

龍華科技大學 函

地址：333326桃園市龜山區萬壽路一段300號

聯絡人：陳信良

電子信箱：DD044@mail.lhu.edu.tw

聯絡電話：(02)8209-3211 轉 5207

傳真電話：(02)82094650

受文者：屏東縣立東港高級中學

發文日期：中華民國115年4月22日

發文字號：龍華工字第1150004079號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第一、二梯次教師營習營半導體研習課程時程及內容 (1151200464_1_21半導體研習課程梯次一.pdf、1151200464_2_21半導體研習課程梯次二.pdf)

主旨：本校辦理114學年度教師產業研習-半導體技術研習課程
(二梯次)，敬邀貴校教師踴躍參與並惠予協助公告，請查
照。

說明：

一、本研習課程共規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢
分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半
導體封裝測試實作」與「企業參訪」，希望透過研習課
程，讓參與研習教師，對於半導體技術能有更全面進一步
地瞭解。

二、旨揭研習課程，共計兩梯次：

(一)梯次一，訂115/06/06(六)、06/07(日)、06/13(六)、06
/14(日)、06/20(六)。115/6/22(一)~6/26(五)共計10
天。

(二)梯次二，訂115/07/04(六)、07/05(日)、07/11(六)、07
/12(日)、07/18(六)。115/7/20(一)~7/24(五)共計10

天。

三、舉辦地點：龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)

四、報名時間：

(一)梯次一，自即日起至115年06月05日中午12：00為止。線

上報名連結：<https://forms.gle/VoiUtTFkWqDqfMFi9>

(二)梯次二，自即日起至115年07月03日中午12：00為止。線

上報名連結：<https://forms.gle/VoiUtTFkWqDqfMFi9>

五、請准予參加人員公(差)假，並依規定由各校服務單位支給差旅費。

六、檢送兩梯次「半導體技術研習課程及時間表」乙份，請依規定於期限內完成報名。

七、研習時數證明PDF檔案將於課程結束後透過電子郵件寄送。

正本：各公私立大專校院、全國高級中等學校

副本：本校半導體工程系



校長葛自祥

龍華科技大學115學年度教師產業研習 半導體技術研習課程 (梯次一)

課程簡介

本研習課程共規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半導體封裝測試實作」與「企業參訪」，希望透過研習課程，讓參與研習教師，對於半導體技術能有更全面進一步地瞭解。

課程時間

115/6/6(六)、6/7(日)、6/13(六)、6/14(日)
115/6/20(六)、6/22(一)~6/26(五) 共計10天

研習地點

龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)

研習人數

名額有限，請儘早報名 (本校教師最多10位)

研習對象

歡迎技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員
教師或有興趣教師均可報名
(若全程出席將可獲得計10天，共60小時研習證書)

報名資訊

即日起至115年6月5日中午12:00為止

報名網址:<https://forms.gle/VoiUtTFkWqDqfMFi9>



報名QRcode

聯絡資訊

聯絡窗口：0905-617506 卓助教

電子信箱：leoathu@gmail.com

115學年度半導體技術研習課程及時間表

日期	時間	課程
115.6.6 (六)	09:00-12:00	全球半導體先進製程趨勢與國際關係
	13:00-16:00	全球半導體產業分析
115.6.7 (日)	09:00-12:00	ESG永續發展簡介
	13:00-16:00	半導體產業淨零碳排及污染改善之 ESG永續推動趨勢
115.6.13 (六)	09:00-12:00	半導體基礎入門
	13:00-16:00	半導體真空介紹
115.6.14 (日)	09:00-12:00	半導體製程介紹 (高溫、電漿應用製程)
	13:00-16:00	半導體製程介紹 (黃光及其他製程、廠務)
115.6.20 (六)	09:00-12:00	半導體製程實作(黃光製程)
	13:00-16:00	半導體製程實作 (薄膜成長、高溫氧化製程)
115.6.22 (一)	09:00-12:00	半導體封裝介紹(切割製程)
	13:00-16:00	半導體封裝介紹(功率元件封裝簡介)
115.6.23 (二)	09:00-12:00	半導體先進封裝
	13:00-16:00	半導體封裝實作 (固晶、導線架、迴焊製程)
115.6.24 (三)	09:00-12:00	半導體測試介紹 (半導體元件測試介紹)
	13:00-16:00	半導體測試介紹 (高頻半導體元件測試)
115.6.25 (四)	09:00-12:00	半導體測試實作 (電性、外觀檢測製程)
	13:00-16:00	半導體測試實作(測試分析實務)
115.6.26 (五)	09:00-16:00	企業實習

龍華科技大學115學年度教師產業研習 半導體技術研習課程 (梯次二)

課程簡介

本研習課程共規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半導體封裝測試實作」與「企業參訪」，希望透過研習課程，讓參與研習教師，對於半導體技術能有更全面進一步地瞭解。

課程時間

115/7/4(六)、7/5(日)、7/11(六)、7/12(日)
115/7/18(六)、7/20(一)~7/24(五) 共計10天

研習地點

龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)

研習人數

名額有限，請儘早報名 (本校教師最多10位)

研習對象

歡迎技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員
教師或有興趣教師均可報名
(若全程出席將可獲得計10天，共60小時研習證書)

報名資訊

即日起至115年7月3日中午12:00為止

報名網址:<https://forms.gle/VoiUtTFkWqDqfMFi9>



報名QRcode

聯絡資訊

聯絡窗口：0905-617506 卓助教

電子信箱：leoathu@gmail.com

115學年度半導體技術研習課程及時間表

日期	時間	課程
115.7.4 (六)	09:00-12:00	全球半導體先進製程趨勢與國際關係
	13:00-16:00	全球半導體產業分析
115.7.5 (日)	09:00-12:00	ESG永續發展簡介
	13:00-16:00	半導體產業淨零碳排及污染改善之 ESG永續推動趨勢
115.7.11 (六)	09:00-12:00	半導體基礎入門
	13:00-16:00	半導體真空介紹
115.7.12 (日)	09:00-12:00	半導體製程介紹 (高溫、電漿應用製程)
	13:00-16:00	半導體製程介紹 (黃光及其他製程、廠務)
115.7.18 (六)	09:00-12:00	半導體製程實作(黃光製程)
	13:00-16:00	半導體製程實作 (薄膜成長、高溫氧化製程)
115.7.20 (一)	09:00-12:00	半導體封裝介紹(切割製程)
	13:00-16:00	半導體封裝介紹(功率元件封裝簡介)
115.7.21 (二)	09:00-12:00	半導體先進封裝
	13:00-16:00	半導體封裝實作 (固晶、導線架、迴焊製程)
115.7.22 (三)	09:00-12:00	半導體測試介紹 (半導體元件測試介紹)
	13:00-16:00	半導體測試介紹 (高頻半導體元件測試)
115.7.23 (四)	09:00-12:00	半導體測試實作 (電性、外觀檢測製程)
	13:00-16:00	半導體測試實作(測試分析實務)
115.7.24 (五)	09:00-16:00	企業實習